

Nowa nota aplikacyjna dotycząca lutowania modułów VI-Chips



Firma Vicor opracowała instrukcję lutowania wyprowadzeń modułów VI-Chips.



Klienci firmy Vicor, którzy kupują podzespoły VI-Chips w wersji SMD (z nóżkami), stoją zawsze przed problemem, jak zintegrować komponenty w procesie lutowania rozpliwowego. Procesy te są zoptymalizowane z reguły dla wielu mniejszych lub przynajmniej istotnie lżejszych elementów układu. Jednakże trudno jest uzyskać połączenie o

najwyższej jakości dla modułów VI-Chips. W dodatku, także kryteria oceny połączenia wyprowadzeń tych podzespołów nie są powszechnie znane.

Dlatego firma Vicor opracowała notę aplikacyjną AN: 009 dotyczącą lutowania modułów VI-Chips. Można w niej znaleźć odpowiedzi na pytania, które często zadają klienci. Opracowanie zawiera następujące punkty:

- warunki przechowywania
- nakładanie pasty lutowniczej
- zasady Pick & Place
- pozycjonowanie nóżek względem pól lutowniczych
- ogrzewanie
- procedury samego lutowania
- lutowanie bezołowiowe i ołowiowe
- proces schładzania
- ocena jakości połączenia
- metody demontażu modułu

Firma Vicor nie zaleca lutowania ręcznego, ponieważ w tym przypadku tylko zewnętrzne fragmenty wyprowadzenia są przylutowane. Poza tym, podczas lutowania ręcznego nie ma możliwości precyzyjnego kontrolowania temperatury.

 Nota aplikacyjna dla modułów VI Chips: [vichip_appnote9_soldering.pdf](#)

 Nota aplikacyjna dla PICOR CoolPower: [an_pi310x_soldering_guidelines.pdf](#)

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl